



日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日                      2 0 0 2 年    1 月 2 3 日  
Date of Application:

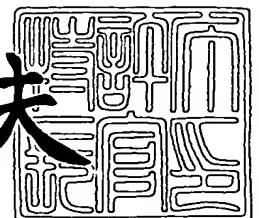
出 願 番 号                      特 願 2 0 0 2 - 0 1 4 3 5 5  
Application Number:  
[ST. 10/C] :                      [ J P 2 0 0 2 - 0 1 4 3 5 5 ]

出      願                      人                      富 士 通 メ デ ィ ア デ バ イ ス 株 式 会 社  
Applicant(s):

2 0 0 3 年 1 0 月 2 1 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号    出証特 2 0 0 3 - 3 0 8 6 8 3 7

【書類名】 特許願

【整理番号】 01092701

【提出日】 平成14年 1月23日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H03H 9/25

【発明の名称】 モジュール部品

【請求項の数】 12

【発明者】

【住所又は居所】 長野県須坂市大字小山 4 6 0 番地 富士通メディアデバイス株式会社内

【氏名】 宮地 直己

【発明者】

【住所又は居所】 長野県須坂市大字小山 4 6 0 番地 富士通メディアデバイス株式会社内

【氏名】 黒川 順子

【特許出願人】

【識別番号】 398067270

【氏名又は名称】 富士通メディアデバイス株式会社

【代理人】

【識別番号】 100094514

【弁理士】

【氏名又は名称】 林 恒▲徳▼

【代理人】

【識別番号】 100094525

【弁理士】

【氏名又は名称】 土井 健二

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 030708

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0004142

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 モジュール部品

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

接続電極がメタライズされた基板と、

前記基板の長手方向に並べて前記基板に搭載され、それぞれバンプを介して前記接続電極と電気的に接続された複数個の部品を有し、

前記複数個の部品を前記基板の接続電極に接続するバンプの高さが、前記基板の長手方向の中央領域に位置するバンプの高さを基準にして、前記基板の辺部に向かって大きくなるように設定されている

ことを特徴とするモジュール部品。

【請求項 2】

接続電極がメタライズされた基板と、

前記基板に搭載され、バンプを介して前記接続電極と電気的に接続された部品を有し、

前記部品は、前記基板の長手方向に対して少なくとも 3 個のバンプにより前記接続電極に接続され、

前記複数個のバンプの高さが、中央領域に位置するバンプの高さを基準にして、前記基板の辺部に向かって大きくなるように設定されている

ことを特徴とするモジュール部品。

【請求項 3】

接続電極がメタライズされた基板と、

前記基板の長手方向に並べて前記基板に搭載され、それぞれバンプを介して前記接続電極と電気的に接続された複数個の部品を有し、

前記複数の部品が前記バンプを介して接続される接続電極の高さが、前記基板の中央領域に位置するバンプに対応する接続電極の高さを基準にして、前記基板の辺部に向かって大きくなるように設定されている

ことを特徴とするモジュール部品。

【請求項 4】

接続電極がメタライズされた基板と、

前記基板に搭載され、バンプを介して前記接続電極と電氣的に接続された部品を有し、

前記部品は、前記基板の長手方向に対し、少なくとも3個のバンプにより前記接続電極に接続され、

前記複数個のバンプのそれぞれに対応する接続電極の高さが、中央領域に位置するバンプに対応する接続電極の高さを基準にして、前記基板の辺部に向かって大きくなるように設定されている

ことを特徴とするモジュール部品。

【請求項5】請求項1～4のいずれかにおいて、

前記基板は、アルミナ層に電極をメタライズした後に、焼成されたセラミック基板であることを特徴とするモジュール部品。

【請求項6】請求項1～4のいずれかにおいて、

前記部品は、前記バンプを介して搭載される基板に対向する面に櫛形電極が形成された弾性表面波素子であって、

更に前記基板の周辺に形成されたパッケージチップとキャップ構造により前記部品が封止されていることを特徴とするモジュール部品。

【請求項7】請求項3又は4において、

前記接続電極の高さが、接続電極の層数により設定されることを特徴とするモジュール部品。

【請求項8】

接続電極がメタライズされた第1の基板と、

前記第1の基板に搭載され、バンプを介して前記接続電極と電氣的に接続された第1の部品と、

前記第1の部品に対応する領域が削り抜かれ、前記第1の基板に積層され、接続電極がメタライズされた第2の基板と、

前記第1の部品上で前記第2の基板に搭載され、バンプを介して前記接続電極と電氣的に接続された第2の部品を有し、

前記第1の部品若しくは前記第2の部品は、複数個の部品であり、

前記複数の部品は、対応する第1又は第2の基板に並べて搭載され、且つこれらの複数の部品が前記バンプを介して接続される前記接続電極の高さが、対応する前記第1の基板又は第2の基板の長手方向の中央領域に位置するバンプに対する接続電極の高さを基準にして、前記第1の基板若しくは第2の基板の辺部に向かって大きくなるように設定されている

ことを特徴とするモジュール部品。

**【請求項9】**

接続電極がメタライズされた第1の基板と、

前記第1の基板に搭載され、バンプを介して前記接続電極と電氣的に接続された第1の部品と、

前記第1の部品に対応する領域が削り抜かれ、前記第1の基板に積層され、接続電極がメタライズされた第2の基板と、

前記第1の部品上で前記第2の基板に搭載され、バンプを介して前記接続電極と電氣的に接続された第2の部品を有し、

前記第1の部品若しくは前記第2の部品は、対応する前記第1の基板若しくは前記第2の基板の長手方向に対し、少なくとも3個のバンプにより前記接続電極に接続され、

前記複数個のバンプの高さが、中央領域に位置するバンプの高さを基準にして、対応する前記第1の基板若しくは前記第2の基板の辺部に向かって大きくなるように設定されている

ことを特徴とするモジュール部品。

**【請求項10】** 請求項8又は9のいずれかにおいて、

前記部品は、前記バンプを介して搭載される基板に対向する面に櫛形電極が形成された弾性表面波素子であって、

更に前記基板の周辺に形成されたパッケージチップとキャップ構造により前記部品が封止されていることを特徴とするモジュール部品。

**【請求項11】** 請求項8又は9のいずれかにおいて、

前記基板は、アルミナ層に電極をメタライズした後に、焼成されたセラミック基板であることを特徴とするモジュール部品。

【請求項 1 2】請求項 8 において、

前記接続電極の高さが、接続電極の層数により設定されることを特徴とするモジュール部品。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、弾性表面波素子等の部品を搭載封入して構成されるモジュール部品に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

近年電子機器の小型化が進み、特に携帯電話端末においては、搭載される電子部品の小型薄型化が要求されている。一方、製造の容易化及び小型化のために複数のチップ部品をパッケージに搭載したモジュール部品が用いられている。

【0 0 0 3】

図 1 は、モジュール部品のパッケージ断面を示す図である。パッケージは、チップキャリア基板 1 とチップキャリア周辺立壁（パッケージチップ）2-1, 2-2 によりチップキャリアを構成し、複数の電子部品を収容する。さらに、キャップ 3 によりパッケージ空間 4 内に複数のチップ部品が搭載封止される。

【0 0 0 4】

チップキャリアは、基板 1 に電極がメタライズされたアルミナ層を焼成して形成される。この時、一例としてパッケージの幅 L が 3 mm 程度と想定すると焼成により基板 1 において、最大寸法 0. 0 3 0 mm の反り MD を生じ、結果としてチップ部品が搭載されるチップキャリア基板 1 に 0. 0 1 0 ~ 0. 0 2 5 mm の高低差 2-2 が生じてしまう。

【0 0 0 5】

これにより、複数のチップ部品がチップキャリアに搭載された状態は図 2 に示すようになる。図 2 A はキャップ 3 を外した状態のチップキャリア断面図であり、図 2 B はチップキャリアを上面からみた図であり、3 つのチップ部品 2 0 ~ 2 2 が基板 1 に並べて搭載されている。

**【0 0 0 6】**

チップ部品 2 0 ~ 2 2 はそれぞれが、バンプ 2 3 を介してメタライズされた接続電極 2 4 に電氣的に接続される。この時、図 2 A に示すように、基板 1 の反り MD により、複数のチップ部品を水平に配置することが困難である。これにより製造過程において困難が生じることになる。

**【0 0 0 7】**

また、特開 2 0 0 0 - 1 5 1 3 4 6 号公報に示されるようなチップ部品を積層されたモジュール部品を製造する場合にも高さ方向の不均一により、搭載されるチップ部品の特性、従って、パッケージ部品の総合的特性にも影響を与え、信頼性を損ねるおそれがある。

**【0 0 0 8】****【発明が解決しようとする課題】**

したがって、本発明の目的は、信頼性を損ねることなく複数の部品を搭載したモジュール部品を提供することにある。

**【0 0 0 9】**

さらに、本発明の目的は、複数の部品を積層してより多くの部品を搭載可能にしたモジュール部品を提供することにある。

**【0 0 1 0】****【課題を解決するための手段】**

上記の本発明の目的を達成するモジュール部品は、その第 1 の態様として、接続電極がメタライズされた基板と、前記基板の長手方向に並べて前記基板に搭載され、それぞれバンプを介して前記接続電極と電氣的に接続された複数個の部品を有し、前記複数個の部品を前記基板の接続電極に接続するバンプの高さが、前記基板の長手方向の中央領域に位置するバンプの高さを基準にして、前記基板の辺部に向かって大きくなるように設定されていることを特徴とする。

**【0 0 1 1】**

上記の本発明の目的を達成するモジュール部品は、その第 2 の態様として、接続電極がメタライズされた基板と、前記基板に搭載され、バンプを介して前記接続電極と電氣的に接続された部品を有し、前記部品は、前記基板の長手方向に



対して少なくとも 3 個のバンプにより前記接続電極に接続され、前記複数個のバンプの高さが、中央領域に位置するバンプの高さを基準にして、前記基板の辺部に向かって大きくなるように設定されていることを特徴とする。

#### 【0012】

上記の本発明の目的を達成するモジュール部品は、その第 3 の態様として、接続電極がメタライズされた基板と、前記基板の長手方向に並べて前記基板に搭載され、それぞれバンプを介して前記接続電極と電氣的に接続された複数個の部品を有し、前記複数の部品が前記バンプを介して接続される接続電極の高さが、前記基板の中央領域に位置するバンプに対応する接続電極の高さを基準にして、前記基板の辺部に向かって大きくなるように設定されていることを特徴とする。

#### 【0013】

さらに、上記の本発明の目的を達成するモジュール部品は、その第 4 の態様として、接続電極がメタライズされた基板と、前記基板に搭載され、バンプを介して前記接続電極と電氣的に接続された部品を有し、前記部品は、前記基板の長手方向に対し、少なくとも 3 個のバンプにより前記接続電極に接続され、前記複数個のバンプのそれぞれに対応する接続電極の高さが、中央領域に位置するバンプに対応する接続電極の高さを基準にして、前記基板の辺部に向かって大きくなるように設定されていることを特徴とする。

#### 【0014】

上記の本発明の目的を達成するモジュール部品は、その第 5 の態様として、接続電極がメタライズされた第 1 の基板と、前記第 1 の基板に搭載され、バンプを介して前記接続電極と電氣的に接続された第 1 の部品と、前記第 1 の部品に対応する領域が削り抜かれ、前記第 1 の基板に積層され、接続電極がメタライズされた第 2 の基板と、前記第 1 の部品上で前記第 2 の基板に搭載され、バンプを介して前記接続電極と電氣的に接続された第 2 の部品を有し、前記第 1 の部品若しくは前記第 2 の部品は、複数個の部品であり、前記複数の部品は、対応する第 1 又は第 2 の基板に並べて搭載され、且つこれらの複数の部品が前記バンプを介して接続される前記接続電極の高さが、対応する前記第 1 の基板又は第 2 の基板の長手方向の中央領域に位置するバンプに対する接続電極の高さを基準にして、前記

第1の基板若しくは第2の基板の辺部に向かって大きくなるように設定されていることを特徴とする。

【0015】

また、上記の本発明の目的を達成するモジュール部品は、その第6の態様として、接続電極がメタライズされた第1の基板と、前記第1の基板に搭載され、バンプを介して前記接続電極と電氣的に接続された第1の部品と、前記第1の部品に対応する領域が刳り抜かれ、前記第1の基板に積層され、接続電極がメタライズされた第2の基板と、前記第1の部品上で前記第2の基板に搭載され、バンプを介して前記接続電極と電氣的に接続された第2の部品を有し、前記第1の部品若しくは前記第2の部品は、対応する前記第1の基板若しくは前記第2の基板の長手方向に対し、少なくとも3個のバンプにより前記接続電極に接続され、前記複数個のバンプの高さが、中央領域に位置するバンプの高さを基準にして、対応する前記第1の基板若しくは前記第2の基板の辺部に向かって大きくなるように設定されていることを特徴とする。

【0016】

上記の本発明の目的を達成するモジュール部品は、その第7の態様として、前記第1～第6の態様の何れかにおいて、前記基板は、アルミナ層に電極をメタライズした後に、焼成されたセラミック基板であることを特徴とする。

【0017】

また、上記の本発明の目的を達成するモジュール部品は、その第8の態様として、前記第1～第6の態様の何れかにおいて、前記部品は、前記バンプを介して搭載される基板に対向する面に櫛形電極が形成された弾性表面波素子であって、更に前記基板の周辺に形成されたパッケージチップとキャップ構造により前記部品が封止されていることを特徴とする。

【0018】

さらに、上記の本発明の目的を達成するモジュール部品は、その第9の態様として、前記第3～第5の態様のいずれかにおいて、前記接続電極の高さが、接続電極の層数により設定されることを特徴とする。

【0019】

本発明の特徴は、更に図面に従い以下に説明される発明の実施の形態から明らかになる。

#### 【0020】

##### 【発明の実施の形態】

図3は、本発明の第1の実施の形態例を示す図である。図3Aは、キャップ3を外した状態のチップキャリア断面図であり、図3Bはチップキャリアの上面からみた図であり、2つのチップ部品20～21がチップキャリアの基板1に並べて搭載されている。

#### 【0021】

この実施の形態例の特徴は、チップキャリアの基板1の反りに対応して、複数のチップ部品20、21をメタライズされた接続電極24に接続するバンプ23-1、23-2の大きさを変えている点にある。

#### 【0022】

すなわち、図3の実施の形態例では、基板1上に接続電極24がメタライズされており、これに複数個（図3においては2個）のチップ部品20、21がバンプ23-1、23-2を介して搭載されている。

#### 【0023】

さらに、前記複数のチップ部品20、21を前記基板1の接続電極24に接続するバンプの高さが、前記基板1の長手方向（図の横方向）の中央領域に位置するバンプ23-1の高さを基準にして、前記基板1の辺部に向かって大きくなる（バンプ23-2参照）ように設定されている。

#### 【0024】

ここで、中央領域に位置するバンプ23-1の高さに対して、基板1の辺部に向かって大きくなるバンプの高さの変化は、基板1の反りの大きさに対応して与えるようにすればよい。これにより、チップキャリアの基板1の反りに対応して、バンプの高さが調整され、チップ部品20、21を水平に搭載可能である。以下の実施の形態例においても同様である。

#### 【0025】

図4は、第2の実施の形態例であり、図3の実施の形態例と同様に、図4Aは

、キャップ3を外したチップキャリア断面図であり、図4Bはチップキャリアの上面からみた図であり、同様に2つのチップ部品20～21が搭載されている。

#### 【0026】

この実施の形態例の特徴は、バンプ23の大きさを均一としている。これに対し、複数のチップ部品20、21がバンプ23を介して接続される接続電極の高さを、前記基板1の中央領域に位置するバンプ23に対応する接続電極24-1の高さを基準にして、前記基板1の辺部に向かって大きくなるように設定されている。

#### 【0027】

このために、図4の実施の形態では、前記基板1の中央領域に位置する第1のメタライズ層24-1を基準にして、前記基板1の辺部に近いメタライズ層は、第1のメタライズ層24-1とその上に重ねて形成される第2のメタライズ層24-2により2層構造として構成されている。

#### 【0028】

これにより、前記基板1の中央領域に位置するバンプ23に対応する接続電極24-1の高さを基準にして、前記基板1の辺部に向かって接続電極の高さが大きくなるように設定される。

#### 【0029】

ここで、中央領域に位置するバンプ23-1の高さに対して、基板1の辺部に向かって大きくなる接続電極の高さ即ち、接続電極を重ねる層数は、基板1の反りの大きさに対応して与えるようにすればよい。これにより、チップキャリアの基板1の反りに対応して、バンプの高さが調整されるのでチップ部品20、21は、水平に搭載可能である。

#### 【0030】

なお、図4の実施の形態において、第1のメタライズ層24-1と24-2による2層構造ではなく、単一層あるいは、2層以上の多層としてそれぞれの接続電極の厚さを調整することも可能である。

#### 【0031】

図5は、本発明の第3の実施の形態例であり、上記の各実施の形態例と同様に

、図 5 A は、キャップ 3 を外したチップキャリア断面図であり、図 5 B はチップキャリアの上面からみた図である。ただし、この実施の形態例では 1 個のチップ部品 2 0 が搭載されている。

#### 【 0 0 3 2 】

さらに、このチップ部品 2 0 には、前記基板 1 の長手方向に対し、少なくとも 3 個以上（図 5 の実施の形態例では 4 個）のバンプ 2 3 - 1, 2 3 - 2 を介して基板 1 の接続電極 2 4 に接続され、搭載されている。

#### 【 0 0 3 3 】

この実施の形態例においては、図 3 の実施の形態例と同様に、中央領域に位置するバンプ 2 3 - 1 の高さを基準にして、基板 1 の辺部に向かって、バンプ 2 3 - 2 の高さを大きくしている。これにより、チップ部品 2 0 の電極が、正しく基板 1 に形成された電極 2 4 に接続されることが可能である。

#### 【 0 0 3 4 】

ここで、前記基板 1 の長手方向に対し、少なくとも 3 個以上とするバンプの数が奇数個である場合は、中央の 1 個のバンプの高さが基準となり、偶数個である場合は、中央領域の 2 個のバンプの高さが基準となる。なお、この図 5 の実施の形態においても図 4 の実施の形態例と同様にバンプの高さを変えずに、接続電極 2 4 の高さを変えるように構成することも可能である。

#### 【 0 0 3 5 】

図 6 は、更に本発明の第 4 の実施の形態例を示す図である。

#### 【 0 0 3 6 】

図 6 A は、パッケージの断面図であり、図 6 B はキャップ 3 を透過してチップキャリアの上面からみた平面図である。図 6 の実施の形態例は、複数のチップ部品を搭載するモジュールの小型化、特に設置面積を小さくできる構成である。

#### 【 0 0 3 7 】

すなわち、先に言及した特開 2 0 0 0 - 1 5 1 3 4 6 号に記載された発明と同様に複数層にチップ部品を積重ねた部品パッケージの構成に本発明を適用した実施の形態例である。

#### 【 0 0 3 8 】

接続電極 24-1 がメタライズされた第 1 の基板 1 にバンプ 23-1 を介して前記接続電極 24-1 と電氣的に接続された第 1 のチップ部品 20 が搭載されている。

#### 【0039】

さらに、この第 1 のチップ部品 20 に対応する領域が刳り抜かれ、前記第 1 の基板 1 に積層され、接続電極 24-2 がメタライズされた第 2 の基板 10 を有している。

#### 【0040】

前記第 1 のチップ部品 20 上に対応する位置で、第 2 の基板 10 に形成された接続電極 24-2 と電氣的に接続された複数（図 6 の例では 2 個）の第 2 のチップ部品 21、22 が、第 2 の基板 10 上に搭載されている。

#### 【0041】

ここで、特徴として、前記第 1 のチップ部品 20 若しくは前記第 2 のチップ部品 21、22 は、バンプ 23-1、23-2 と接続電極 24-1、24-2 との関係において、先に説明した実施の形態例の特徴を利用している。

#### 【0042】

すなわち、対応する前記第 1 の基板 1 には、1 個のチップ 20 が搭載されている。このとき、チップ 20 と、基板 1 との関係は、図 5 により説明したと同様である。チップ 20 は、基板 1 の長手方向に対し、少なくとも 3 個のバンプ 23-1 により接続電極 24-1 に接続されている。

#### 【0043】

そして、複数個のバンプ 23-1 の高さが、中央領域に位置するバンプの高さを基準に、対応する前記第 1 の基板 1 の辺部に向かって大きくなるように設定されている。この際、バンプ 23-1 の高さの変化は、基板 1 の反りの大きさに対応して与えるようにすればよい。これにより、チップキャリアの基板 1 の反りに対応して、バンプの高さが調整されているのでチップ部品 20 は、水平に搭載可能である。

#### 【0044】

一方、図 6 において、チップ 20 上に対応し、且つ第 2 の基板 10 上にチップ

21, 22が搭載されている。このとき、第2の基板10とチップ21, 22の関係は、図3と同様である。第2の基板10の長手方向の中央領域に位置するバンプの高さを基準にして、前記第2の基板若しくは第2の基板の辺部に向かって、接続電極24-2の高さが大きくなるように設定されたバンプにより接続されている。

#### 【0045】

この時、バンプの高さ或いは、接続電極の高さの変化は、先の実施の形態例と同様に、基板10の反りの大きさに対応して与えるようにすればよい。これにより、チップキャリアの基板10の反りに対応して、バンプの高さが調整されているのでチップ部品21, 22は、水平に搭載可能である。

#### 【0046】

なお、チップ20, 21, 22のバンプ23-1, 23-2を介しての接続電極24-1, 24-2との接続は、バンプの高さを変えずに、チップ20, 21及び22が接続される接続電極24-1, 24-2の高さを図4と同様に、変化させるようにしても良い。

#### 【0047】

図6において、更に第2の基板10上には、キャリアチップ11が設けられている。さらに、このキャリアチップ11上にキャップ3が被せられてチップ部品20～22が搭載封止される。

#### 【0048】

ここで、図6の実施の形態において、第1の基板1には、1個のチップ20が搭載され、第2の基板10の2個のチップ21, 22が搭載されるように示されているが、本発明の適用はこれに限定されないで、逆の関係にあっても良い。すなわち、第1の基板1に複数個のチップ部品を、そして、第2の基板10に1個のチップ部品を搭載するように構成しても良い。

#### 【0049】

あるいは、第1の基板1及び、第2の基板10のそれぞれに単一又は複数のチップ部品を搭載しても良い。この場合の、チップ部品がバンプを介して接続電極に接続される関係は、図3～図5に示した通りである。

**【0 0 5 0】**

なお、上記実施の形態例において、チップ部品として、弾性表面波素子が適用可能であるが、その他のいずれの目的の部品であっても、本発明の適用が制限されるものではない。

**【0 0 5 1】****【発明の効果】**

上記に実施の形態例を図面に従い説明したように、本発明により、信頼性を損ねることなく複数の部品を搭載したモジュール部品の提供及び、部品を積層してより多くの部品を搭載可能にしたモジュール部品が提供可能である。

**【図面の簡単な説明】****【図 1】**

モジュール部品のパッケージ断面を示す図である。

**【図 2】**

複数のチップ部品がチップキャリアに搭載された状態を示す図である。

**【図 3】**

本発明の第 1 の実施の形態例を示す図である。

**【図 4】**

本発明の第 2 の実施の形態例を示す図である。

**【図 5】**

本発明の第 3 の実施の形態例を示す図である。

**【図 6】**

本発明の第 4 の実施の形態例を示す図である。

**【符号の説明】**

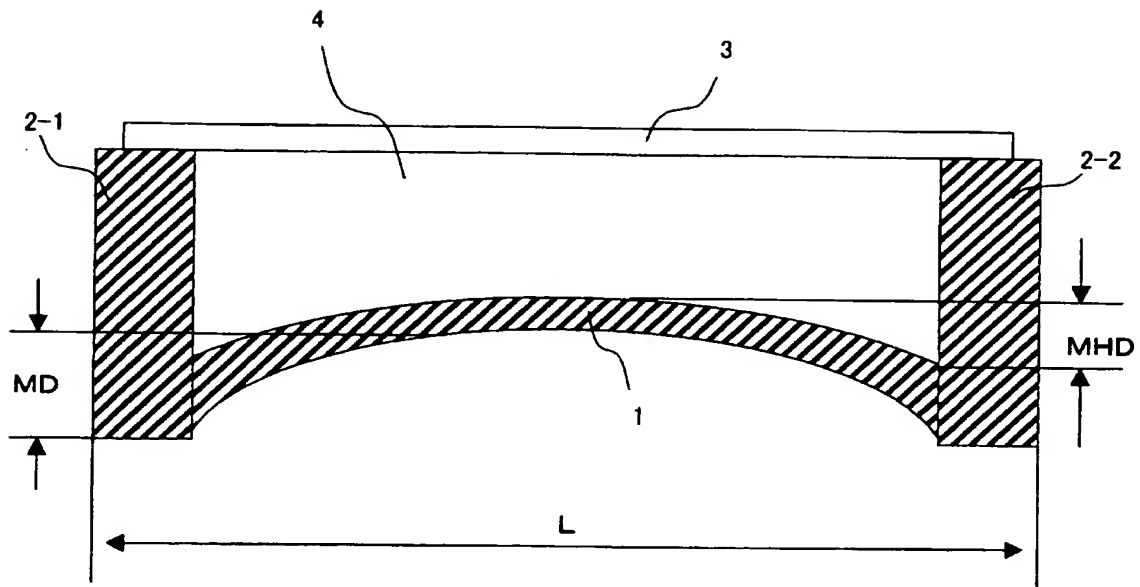
- 1   チップキャリア基板 1
- 2-1, 2-2   チップキャリア周辺立壁
- 3   チップキャリアキャップ
- 4   パッケージ空間
- 20~22   チップ部品
- 23   バンプ



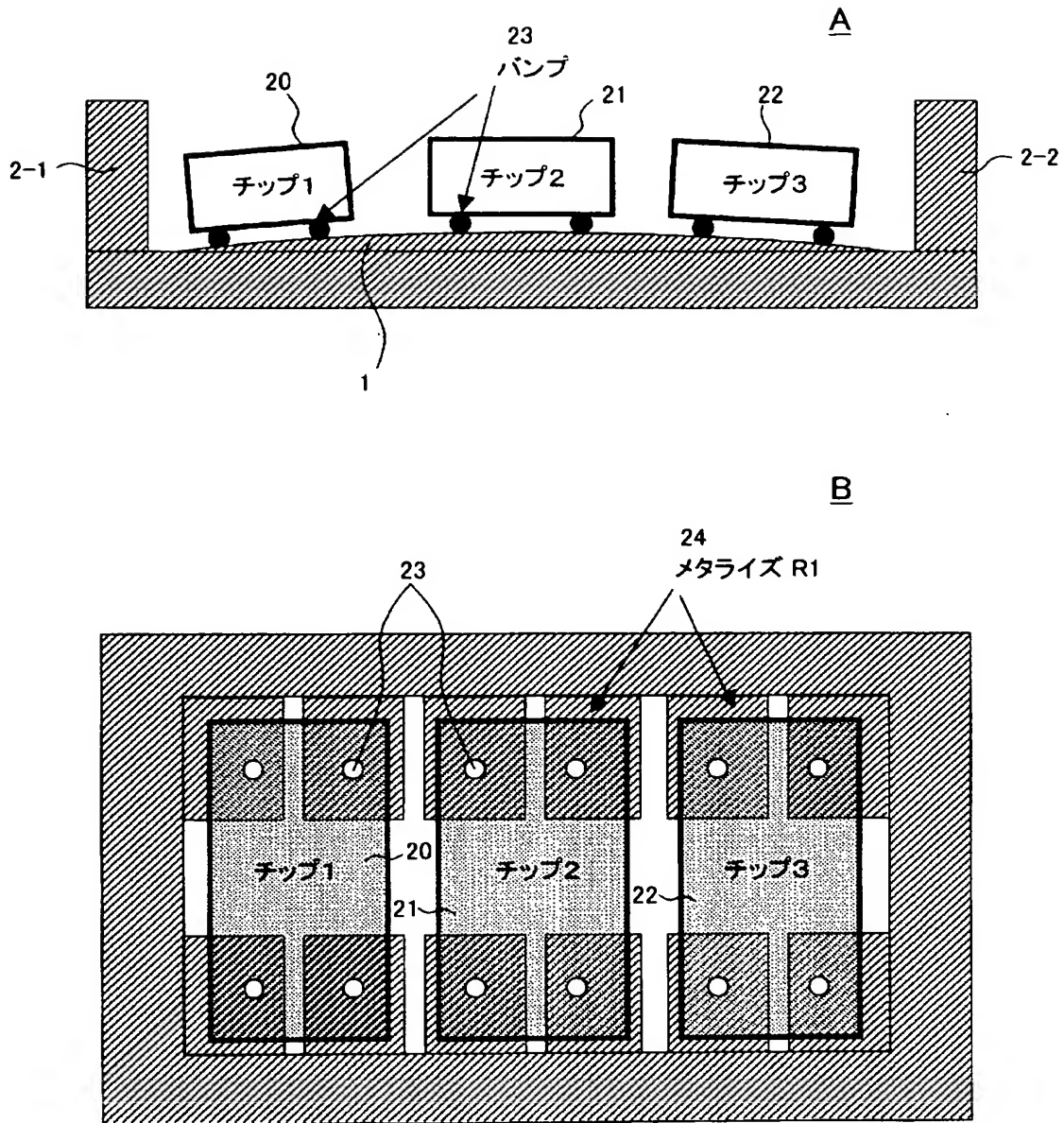
2 4 接続電極

【書類名】 図面

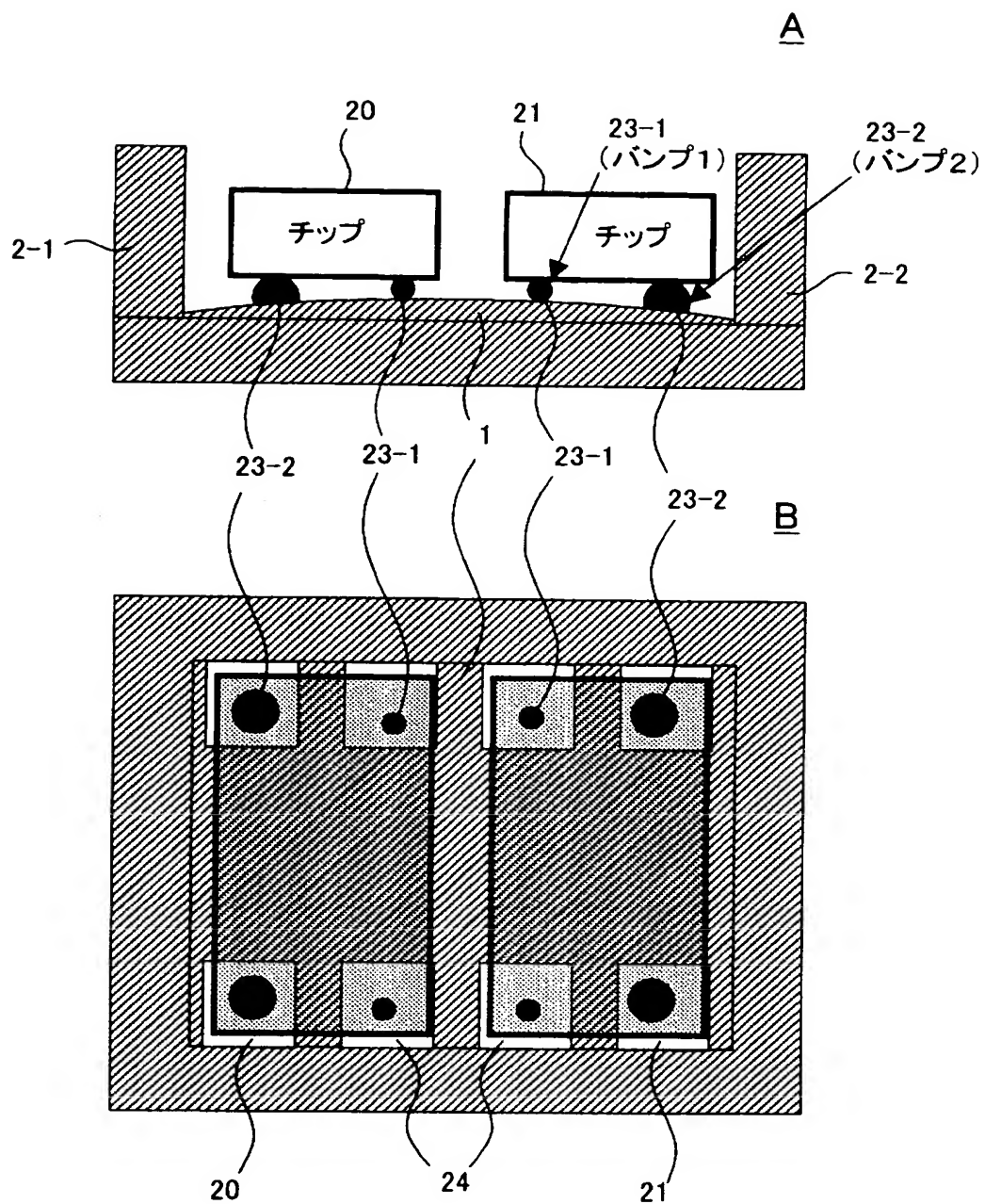
【図 1】



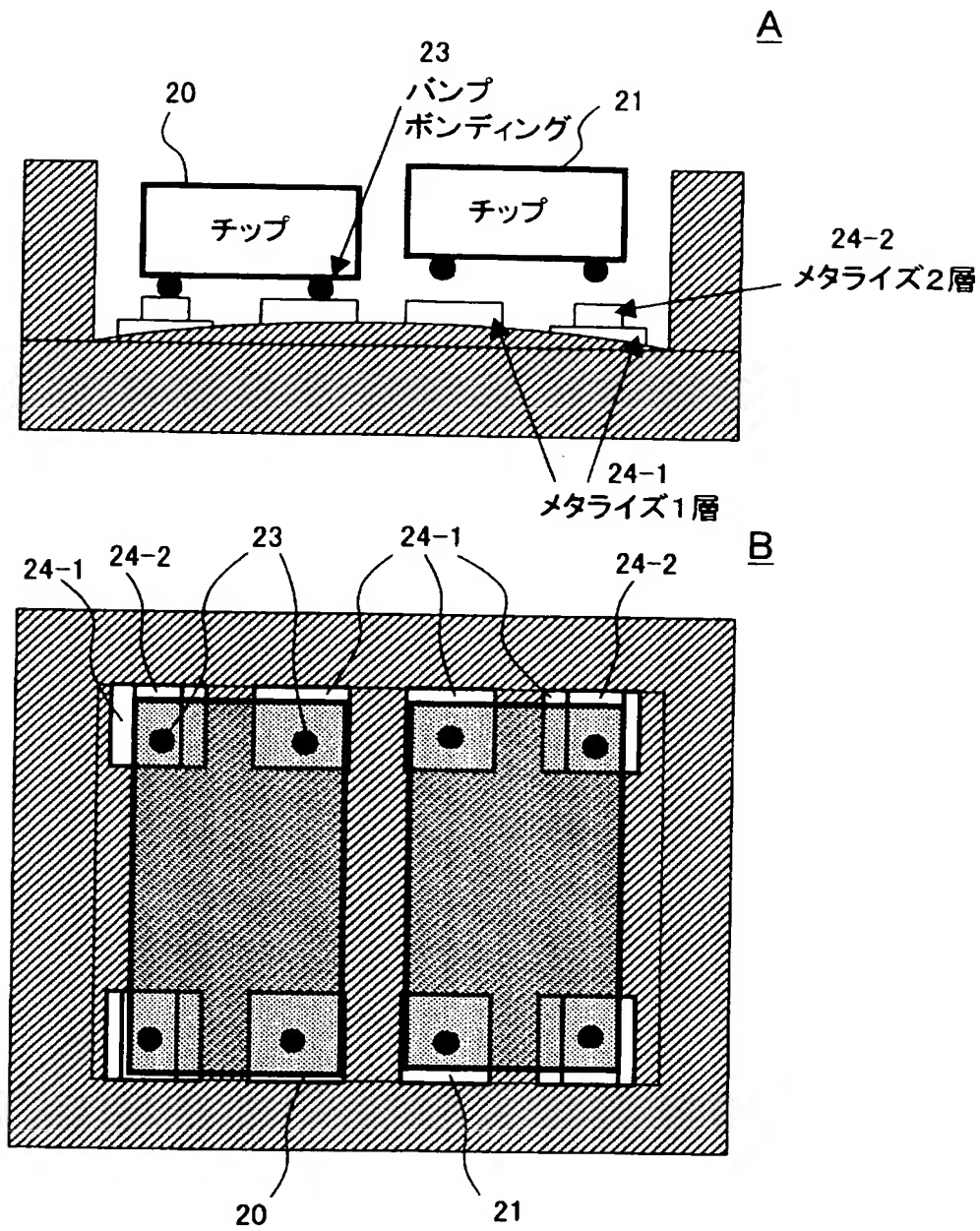
【図 2】



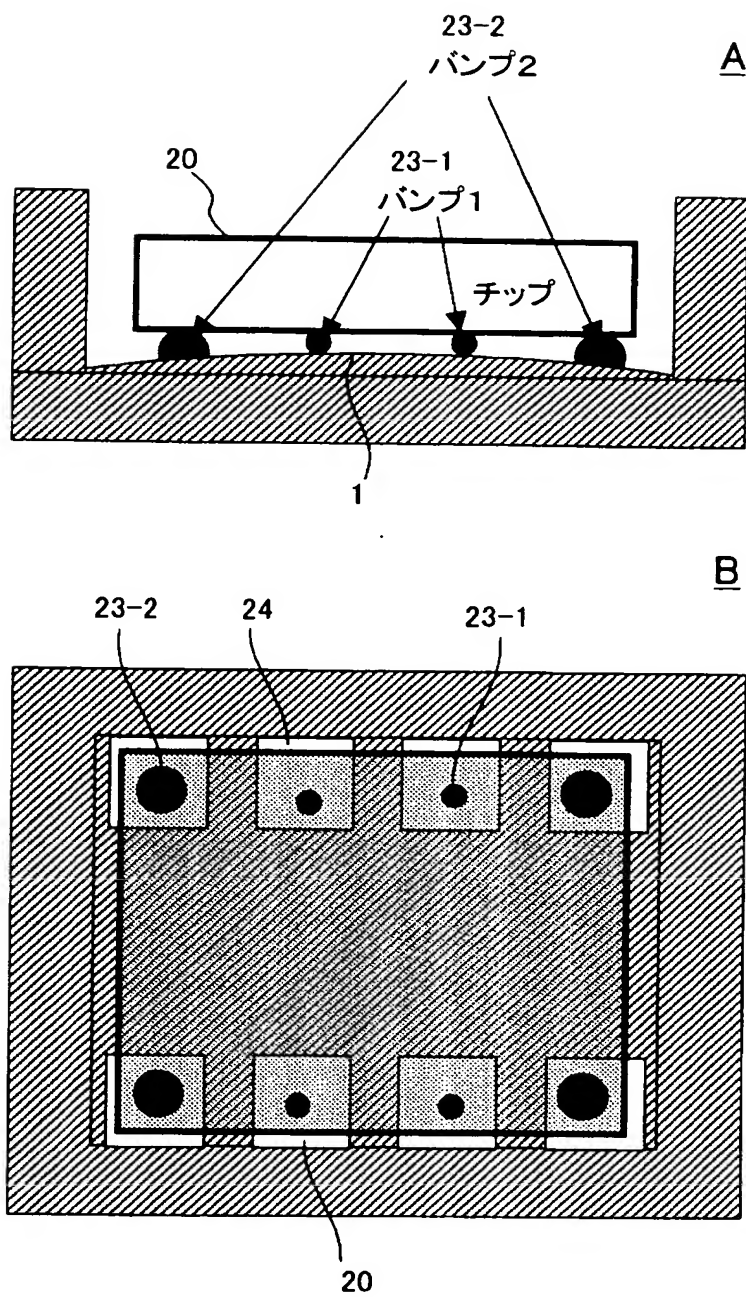
【図3】



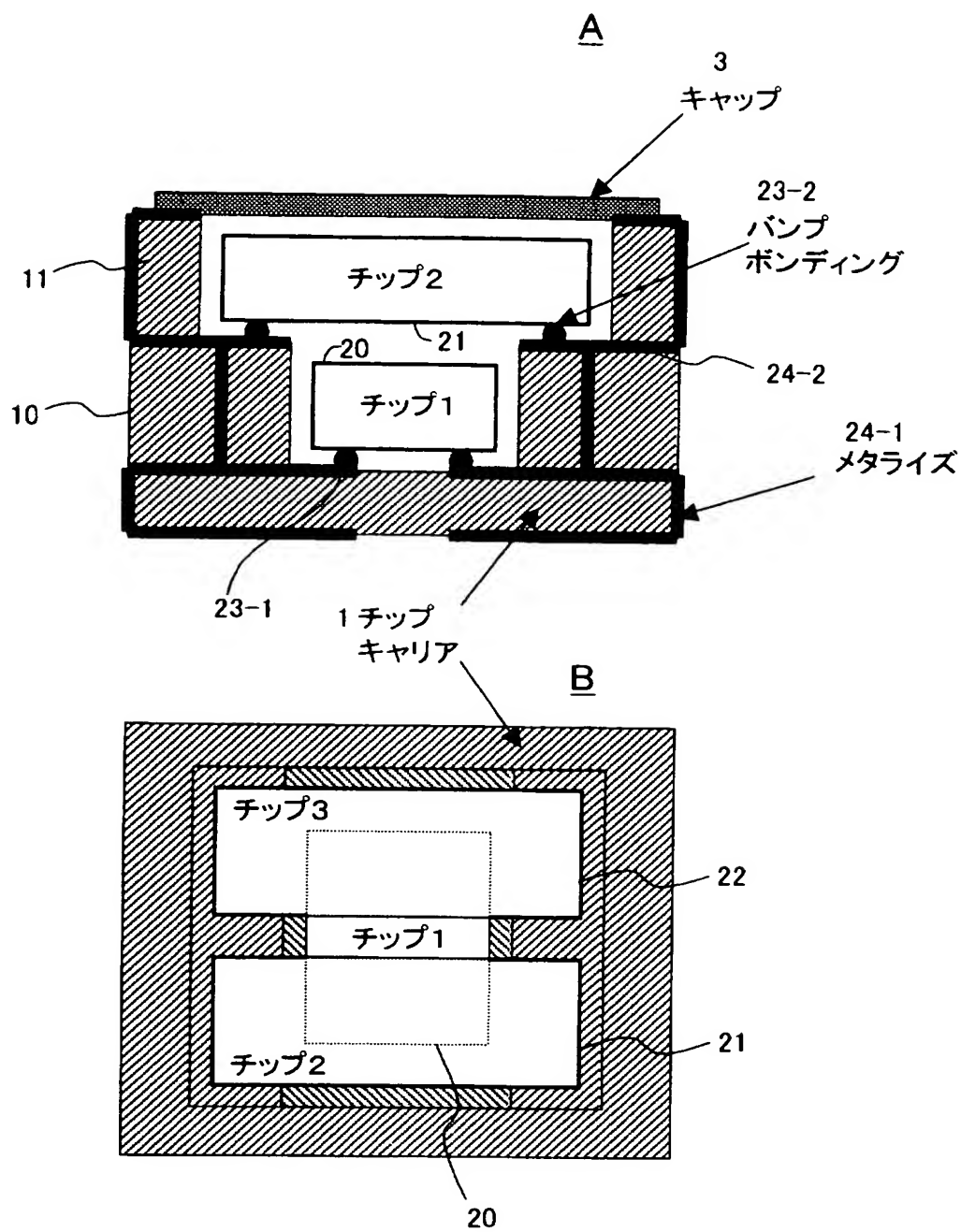
【図 4】



【図 5】



【図 6】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】信頼性を損ねることなく複数の部品を搭載したモジュール部品を提供する。

【解決手段】接続電極がメタライズされた基板と、前記基板の長手方向に並べて前記基板に搭載され、それぞれバンプを介して前記接続電極と電氣的に接続された複数の部品を有し、前記複数の部品を前記基板の接続電極に接続するバンプの高さが、前記基板の長手方向の中央領域に位置するバンプの高さを基準にして、前記基板の辺部に向かって大きくなるように設定されている。

【選択図】 図 3



## 認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2002-014355
受付番号	50200084208
書類名	特許願
担当官	風戸 勝利 9083
作成日	平成14年 1月29日

## &lt;認定情報・付加情報&gt;

## 【特許出願人】

【識別番号】 398067270

【住所又は居所】 長野県須坂市大字小山460番地

【氏名又は名称】 富士通メディアデバイス株式会社

## 【代理人】 申請人

【識別番号】 100094514

【住所又は居所】 神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-5 第三東  
昇ビル3階 林・土井 国際特許事務所

【氏名又は名称】 林 恒徳

## 【代理人】

【識別番号】 100094525

【住所又は居所】 神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-5 第三東  
昇ビル3階 林・土井 国際特許事務所

【氏名又は名称】 土井 健二

次頁無

特願 2002-014355

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[398067270]

- |          |                       |
|----------|-----------------------|
| 1. 変更年月日 | 1998年10月26日           |
| [変更理由]   | 新規登録                  |
| 住 所      | 長野県須坂市大字小山460番地       |
| 氏 名      | 富士通メディアデバイス株式会社       |
| 2. 変更年月日 | 2002年10月28日           |
| [変更理由]   | 住所変更                  |
| 住 所      | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番地12 |
| 氏 名      | 富士通メディアデバイス株式会社       |
| 3. 変更年月日 | 2002年11月 5日           |
| [変更理由]   | 住所変更                  |
| 住 所      | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番12号 |
| 氏 名      | 富士通メディアデバイス株式会社       |
| 4. 変更年月日 | 2003年 5月30日           |
| [変更理由]   | 住所変更                  |
| 住 所      | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番地12 |
| 氏 名      | 富士通メディアデバイス株式会社       |